기술분석 2022-101

2022.02.17.

이 보고서는 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서 | YouTube 요약 영상 보러가기

다믈멀티미디어(093640)

반도체

요 약
기업현황
시장동향
기술분석
재무분석
주요 변동사항 및 전망

작성기관	한국기업데이터(주)	작 성 자	신지혜 선임전문위원

■ 본 보고서는 「코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안」의 일환으로 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해, 한국거래소와 한국예탁결제원의 후원을 받아 한국IR협의회가 기술신용평가기관에 발주하여 작성한 것입니다.

■ 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.

■ 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미게재 상태일 수 있습니다.

■ 카카오톡에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.

■ 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-3215-2398)으로 연락하여 주시기 바랍니다.

한국IR협의회

다믈멀티미디어(093640)

첨단 디지털 기술을 제공하는 SoC 설계 전문 기업

기업정보(2022/2/9 기준)

대표자	정집훈
설립일자	1998년 12월 18일
상장일자	2007년 10월 19일
기업규모	중소기업
업종분류	비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업
주요제품	AP IC, Optical MP3 IC, DAB IC, Multimedia Interface IC 외

시세정보(2022/2/9 기준)

현재가(원)	4,000
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	728
발행주식수(주)	18,248,289
52주 최고가(원)	6,150
52주 최저가(원)	2,655
외국인지분율	0.00%
주요주주	(주)베노홀딩스 16.35%, (주)라미쿠스 8.78%, 정집훈 0.70% 외

■ 멀티미디어와 통신용 비메모리 반도체 설계 전문 기업

다믈멀티미디어(주)는 멀티미디어 반도체의 제조 및 판매 등을 목적으로 1998년 12월에 설립되었으며, 2007년 10월 코스닥 증권시장에 상장되었다. 분기보고서(2021년 9월) 기준 주요 관계회사로는 (주)베노홀딩스, (주)제이앤제이인베스트먼트, (주)베노바이오, (주)라미쿠스, SKY TOUCH CO.,Ltd, (주)제이앤파크 등이 있다.

■ 차량용 반도체 부족, 2022년에도 수급 불균형 지속될 예정

최근 자동차 판매 증가 및 파운드리 기업의 생산능력 제약 등으로 차량용 반도체 부족 사태가 발생했다. 그러나 글로벌 반도체 업체 입장에서는 차량용 반도체의 수익성이 여전히 낮아 생산능력 확충에 적극적이지 않은 반면, 첨단 전자장비가 적용되는 전장화와 전기차 전환 가속화로 수요는 급증하는 추세이며, 차량용 반도체 물량이 나오기까지는 상당한 시간이 소요되어 2022년에도 차량용 반도체의 수급 불균형은 지속될 것으로 전망된다.

국내 자동차 산업도 반도체 공급 부족 장기화 시 생산차질이 불가피하며, 우리나라 팹리스 기업은 완성차 기업의 부품 공급사 다변화 추진으로 차량용 반도체 사업 기회가 확대될 가능성이 있어, 차량용 반도체 개발을 하고 있는 다믈멀티미디어(주) 역시 수혜를 받을 수 있을 것으로 기대된다.

■ 최대주주 및 대표이사 변경

2021년 8월, 다믈멀티미디어(주)는 기존 최대주주였던 (주)우리로가 보유주식 합계 보통주 168만 5,693주를 150억 원에 (주)베노홀딩스에 양도하는 주식양수도 계약을 체결했다고 공시했다. 이 계약으로 2021년 10월 잔금지급 및 주권 이전이 완료됨에 따라, 최대주주가 (주)베노홀딩스로 변경되었으며, 이에 따라 (주)베노홀딩스의 대표이사인 정집훈이 다믈멀티미디어(주)의 대표이사직을 맡게 되었으며, 현재 (주)베노홀딩스와 다믈멀티미디어(주)를 겸영 중에 있다.

요약 투자지표 (K-IFRS 별도 기준)

구분 / 년	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2018	111	-39.30	-26	-23.05	-36	-32.47	-57.58	-27.78	76.40	-514	1,067	N/A	4.01
2019	131	18.07	10	7.92	5	4.08	3.62	2.22	57.72	53	1,961	67.76	1.85
2020	89	-32.47	1	1.60	-11	-12.88	-4.99	-3.54	26.68	-101	1,956	N/A	1.74

기업경쟁력

시장 선점을 위한 판매 전략 구축

■ SoC화를 통한 최종 제품의 원가 절감
■ 기획부터 최종 판매까지 지속적인 기술지원

지속 성장을 위한 R&D 역량 보유

■ 3년간 평균 연구개발투자비율 11.2%(산업 평균 3.7%)
■ SoC 선도 기업을 향한 지속적인 R&D 인력 강화

핵심기술 및 주요제품

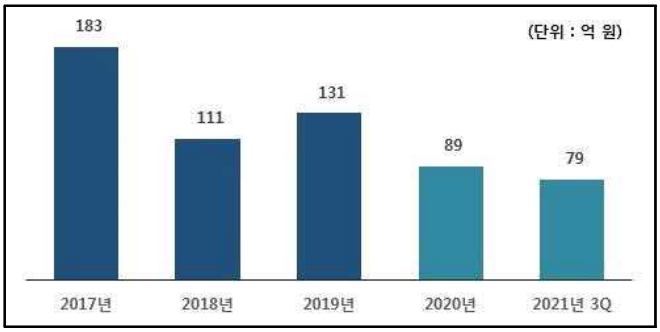
핵심기술

■ 고성능 및 다기능을 가진 Multimedia SoC IC 개발
■ Full HD급 Video를 지원하는 AP IC 개발
■ Set Maker 맞춤형 제품 설계 기술

주요제품

■ 비메모리 반도체
- AP(Application Processor) IC, Optical MP3 IC, DAB(Digital Audio Broadcasting) IC, Multimedia IC

매출실적



시장현황

시스템 반도체 세계 시장

■ PC, 모바일, 서버 등 IT 기기 발달과 함께 최근 4차 산업혁명의 본격화로 시장규모 지속 확대 중
■ 세계 시스템 반도체 시장 규모
2020년 2,437억 달러 → 2022년(E) 3,200억 달러,
전체 반도체 시장에서 시스템 반도체의 점유율 54%

최근 변동사항

차량용 반도체 부족, 2022년 지속

■ 자동차 수요예측 실패, 파운드리 기업의 생산 제약 → 차량용 반도체 부족 사태 발생
■ 전기차 전환 가속화로 수요 급증 → 수급 불균형 지속

최대주주 및 대표이사 변경

■ 2021년 8월, (주)우리로와 (주)베노홀딩스 주식양수도 계약 체결 → 10월, 최대주주 (주)베노홀딩스로 변경
■ 2021년 10월, 대표이사 박세철 → 정집훈으로 변경

ESG(Environmental, Social and Governance) 활동 현황

ESG	Issue	Action
ENVIRONMENTAL	- 탄소중립 정책에 따른 공정 개선 - 자원이용, 안전보건 등 환경 이슈 가능성은 타 업종에 비해 낮은 편 - ESG 경영 세계적 이슈	- 환경경영(ISO 14001), 에너지 절약 및 모니터링 강화로 친환경 생산과 소비에 기여 - 환경경영의 필요성 인지 → 관련 활동 계획 수립 중 - ESG 동향조사, 도입시기, 조직구성 등 검토 필요
SOCIAL	- 제품 특성상 높은 신뢰성과 품질안정성 요구 - 조직문화, 직원 복지 및 근무환경 - 거래처 및 협력업체와의 관계 - 기술보호, 유출 및 정보보안	- ISO 9001, 벤처기업, 이노비즈 등 인증 보유 - 수년간 기간제 근로자 채용 없이 정규직으로 채용 중 - 다양한 복리후생제도 운영(경조사비, 건강검진비, 자기개발비, 부서운영비 등 지원, 기념일 선물 지급)
GOVERNANCE	- 준법경영, 부패방지 및 내부고발 - 정보관리 및 정보보호 - 이해관계자 소통을 위한 채널 다양성 확보 - 합리적인 의사결정 및 투명한 제도	- 소통 확대를 위한 홈페이지 지속 업데이트 - 홈페이지를 통한 기업 활동 적극적인 공개 - 연구 자율성 보장과 꾸준한 기술개발을 위한 조직체계 확립으로 산업 성장과 혁신에 기여

한국기업데이터(주)의 ESG 평가항목 기반 자체 데이터, 언론자료 및 제출자료 등을 통해 Issue와 Action을 구성하고 이를 SDGs와 연계

Ⅰ. 기업현황

멀티미디어와 통신용 비메모리 반도체 설계 전문 기업

동사는 멀티미디어 반도체를 개발 판매하는 반도체 설계전문회사로서, 본 분야에 축적된 기술력을 바탕으로 자체 제품을 개발하여 전 세계 시장에 출시하고 있다.

■ 회사 연혁 및 주요 사업 분야

다믈멀티미디어(주)(이하 '동사')는 멀티미디어 반도체의 제조 및 판매 등을 목적으로 1998년 12월에 설립되었으며, 2007년 10월 코스닥 증권시장에 상장되었다. 분기보고서(2021년 9월) 기준 주요 관계회사로는 (주)베노홀딩스, (주)제이앤제이인베스트먼트, (주)베노바이오, (주)라미쿠스, SKY TOUCH CO.,Ltd, (주)제이앤파크 등이 있다.

동사는 비메모리 반도체를 개발 판매하는 반도체 설계전문회사(Fabless)로서 멀티미디어 분야의 핵심 기술인 SoC(System On a Chip) 설계 기술을 바탕으로 AP(Application Processor) IC, Optical MP3 IC, Multimedia Interface IC, DAB(Digital Audio Broadcasting) IC 등의 사업부문에 중점을 두고 있다.

[그림 1] 동사 제품이 적용되는 타겟 시스템

***출처 : 동사**

■ 대표이사 정보 및 주요 주주 현황

대표이사 정집훈(1972년생, 남)은 서울대학교 경영대학원을 졸업하였고, 삼일회계법인, 회계법

인리안, (주)이그잭스(대표이사), (주)베노홀딩스(대표이사), (주)베노바이오(대표이사)에서 근무한 경험을 바탕으로 2021년 10월 대표이사에 취임하여 현재까지 경영전반을 총괄하고 있다.

동사의 분기보고서(2021년 9월) 기준 최대 주주는 13.26%의 지분을 보유한 (주)베노홀딩스이며, 대표이사는 동사와 동일한 정집훈으로 동사의 관계회사이다. 대표이사를 포함한 특수관계인의 지분을 합하면 약 22.74% 수준이다.

[표 1] 주요주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

성명	동사와의 관계	주식(주)	지분율(%)
(주)베노홀딩스	관계회사	2,419,308	13.26
(주)라미쿠스	관계회사	1,602,564	8.78
정집훈	대표이사	128,205	0.70
계		**4,150,077**	**22.74**

***출처 : 동사 분기보고서(2021년 9월)**

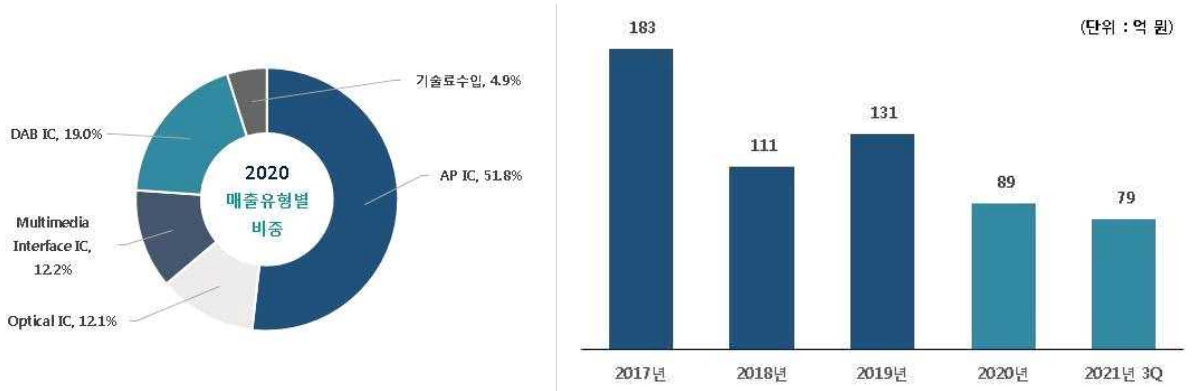
■ 주요 Partners & Customers

[그림 2] 주요 거래처

***출처 : 각사 홈페이지**

■ 매출 현황

[그림 3] 매출 유형별 비중(좌), 연도별 매출현황(우)



*** 출처 : 동사 연도별 사업보고서, 반기보고서(2021년 6월), 한국기업데이터(주) 재가공**

Ⅱ. 시장 동향

신수요 발생, 신기술 출현 등으로 경쟁구도가 변화되는 추세

세계 반도체 시장은 PC · 모바일 · 서버 등 IT 기기 발달과 함께 시장규모도 지속 확대해왔으며, 최근 4차 산업혁명의 본격화로 비메모리 반도체 시장의 대표적인 시스템 반도체 시장도 지속적인 상승이 전망된다.

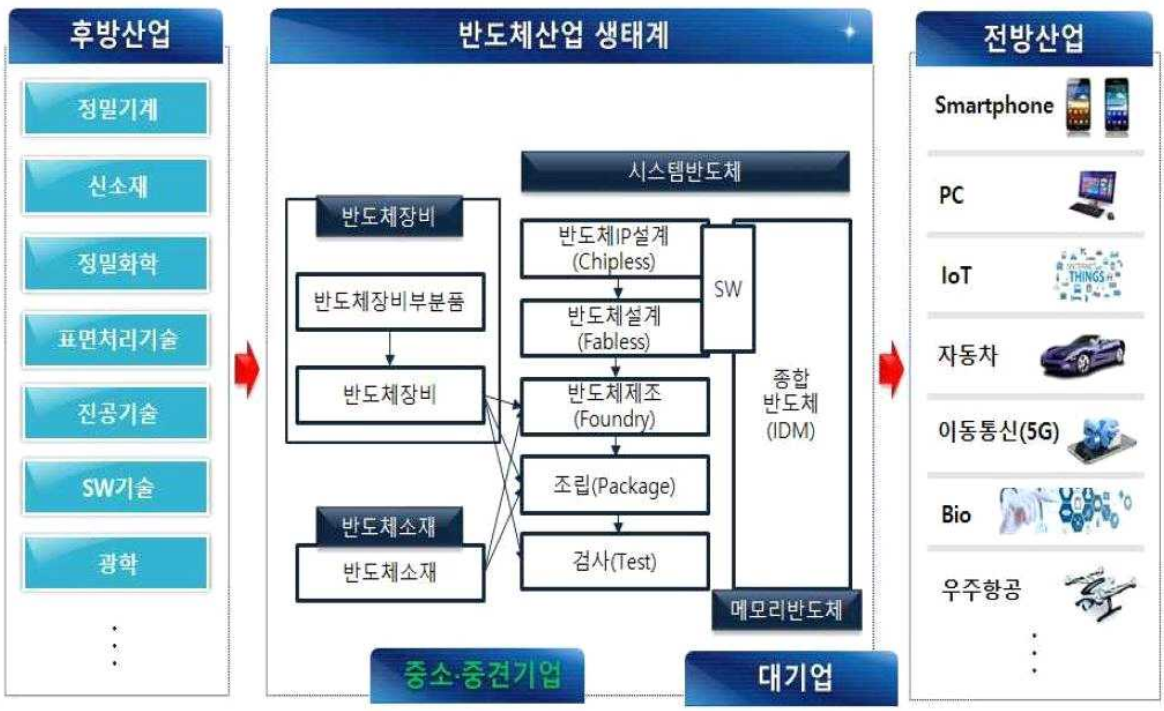
■ 지속적인 인적/물적 투자가 필요한 반도체 산업

반도체는 타이밍 산업, 기간산업, 지속적인 인적 물적 투자가 필요한 산업으로, 질적으로 우수한 전문 인력을 육성하여 이를 적기 투입하는 것이 중요하다.

특히, 반도체는 제품의 수명 주기(Life Cycle)가 짧고, 기술개발 속도가 점점 빨라지고 있어 적기에 제품을 개발, 판매하여 최대의 이익을 확보하는 것이 필요하며, 타 제품에 비해 반도체 제품의 초기 가격은 시간이 지남에 따라 급격하게 하락하는 특성을 가지고 있으며, 세계 반도체 시장은 일정 주기로 호황과 불황을 되풀이하는 사이클을 가지고 있어 시장에 가장 먼저, 최적의 시기에 진입하는 것이 기업의 사활을 결정짓는 중요 요소이다.

또한, 기술집약적인 산업으로 반도체 산업의 비약적인 성장은 반도체 산업만의 발전에 그치지 않고, 기계 및 재료 산업과 정보통신 등 IT 산업 전반에 미치는 영향이 매우 크며, 전방으로는 반도체 생산에 필요한 재료 및 장비 산업과 연관되어 있고, 후방으로는 반도체를 핵심부품으로 사용하는 전자기기 및 시스템 산업과 연관되어 있다.

[그림 4] 반도체 산업 생태계



*출처 : 전자산업 인적자원개발위원회, 반도체 산업 현황과 인력양성 방향(2019년)

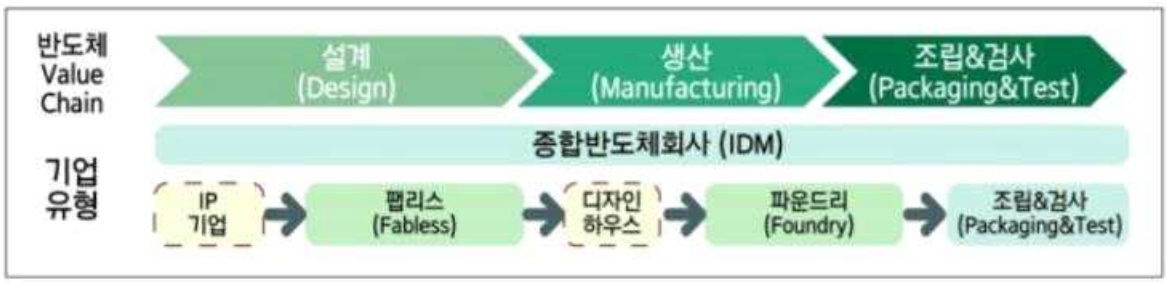
반도체 산업은 4차 산업혁명으로 인한 신산업의 도래에 따라 반도체 시장의 지속적인 성장세 및 영역확대가 광범위하게 이뤄질 것으로 기대되며, 반도체 제품의 집적도가 높아지고 고성능/저전력화 됨에 따라 미세 공정 등에 따른 신공정 도입과 관련 장비 수량 증가 등으로 설비투자 규모가 지속 증가할 예정이다.

■ 종합 반도체 업체에서 전문성 업체로 분화

반도체 산업은 초기 대부분 일괄로 공정을 수행하는 종합 반도체 기업(IDM)들이 설립되었으나, 점차 분야별 분업화되어 펩리스, 파운드리, 패키징 · 테스트, 칩리스 등이 등장하였다.

동사는 비메모리 반도체 설계전문회사인 펩리스 회사로 분류된다. 펩리스는 생산설비가 없는 설계 전문업체이며, 위탁제조업체인 파운드리는 펩리스 주문에 대응하여 웨이퍼에 회로 패턴 형성을 담당하는 업체이다. 패키징 · 테스트 전문 업체는 회로패턴이 형성된 웨이퍼를 자르고 조립하여 최종 제품인 반도체 칩을 만들고 성능 및 신뢰성 테스트를 담당하고 있으며, IP(Intellectual Property, 반도체 설계자산) 설계업체인 칩리스는 설계기술을 개발하여 IP를 종합 반도체 업체나 펩리스에 IP를 제공하고 있다.

[그림 5] 반도체 산업의 Value Chain 및 기업 유형



***출처 : 산업통상자원부**

[표 2] 반도체 공정 카테고리별 사업 내용 및 주요 업체

공정별 분류	비즈니스 모델별 분류	사업 특성	주요 업체
전공정	IDM	▪ 칩 설계에서 제조 및 테스트까지 일괄공정체제 구축 ▪ 메모리제조의 가장 성숙한 모델 ▪ 기술력과 규모의 경제를 통한 경쟁 확보 ▪ 거대투자의 고위험 고수익 형태	Intel, 삼성전자, SK하이닉스, Micron, Toshiba, TI, STMicro, Reesas
	Fabless	▪ 칩의 설계만 전문으로 하는 업체 ▪ 고정비의 대부분은 연구개발 및 인력비 ▪ 고위험 거대투자를 회피할 수 있으나, 위탁제조 비용 부담 필요	Qualcomm, Broadcom, Xilinx, NVIDIA, AMD, MediaTek, HiSilicon, 실리콘웍스
	Foundry	▪ 주문방식에 의해 칩 생산만 전문 ▪ 칩을 설계하지 않고, 설계전문 업체로부터 위탁제조	TSMC, GlobalFoundries, UMC, SMIC, 동부하이텍
후공정	패키징 및 테스트	▪ 완성된 웨이퍼를 받아 조립 및 테스트를 하는 업체 ▪ IDM, Foundry에 이어 많은 자본을 필요로 함	Amkor, ASE, 네패스, 테스나, SFA반도체, 엘비세미콘

***출처 : MSD(Motion System Design) 4차 산업혁명 뉴스 포탈, 한국기업데이터(주) 재가공**

■ 주문형 개발, 다품종 소량 생산에 적합한 시스템 반도체

반도체는 크게 메모리 반도체와 비메모리 반도체(시스템 반도체, 광 · 개별 소자)로 나눌 수 있다. 시스템 반도체 산업은 시장구조 · 사업구조 · 핵심 경쟁력 등에서 메모리 반도체 산업과 대조적인 특징을 보이고 있는데, 메모리 반도체는 소품종 대량 생산에 유리하여 IDM 방식이 효율적이지만, 시스템 반도체의 경우 시스템 업체별 요구하는 사양과 성능이 달라 다품종 소량 생산에 특화되어 있고, 상대적으로 시장집중도가 낮다.

또한, 메모리 반도체 산업에 비해 중소 및 벤처기업이 진입하기에 용이한 편이지만, 종합 반도체 기업 또는 팹리스 대기업과 경쟁이 불가피하며, 설계 단계에서 고도의 공학 지식이 필요하고, 양산 능력이 필요하여 기술적 진입장벽이 높은 산업이다.

이 밖에도 경기 및 전방산업의 수요변화에 영향을 많이 받는 메모리 반도체와 달리 시스템 반도체는 광범위한 적용 분야, 다품종 소량생산 구조, 고도의 설계기술 요구 등으로 수요 변화에 비교적 비탄력적인 편이다.

[표 3] 반도체 산업 특성 비교

메모리 반도체	시스템 반도체
생산기술 지향	설계기술 지향
D램 등 품목 소수	용도별 품목 다양
소품종 대량 생산	다품종 소량 생산
대기업형 사업구조	중소·벤처형 사업구조
선행기술 개발 중요	우수 설계인력 관건
높은 위험부담	낮은 위험부담
참여업체 제한적	참여업체 많고 다양

***출처 : KDB 산업은행**

■ 4차 산업혁명의 본격화로 지속적인 성장이 기대되는 시스템 반도체 시장

세계 반도체 시장은 PC · 모바일 · 서버 등 IT 기기 발달과 함께 시장규모도 지속 확대해왔으며, 최근 4차 산업혁명의 본격화로 시스템 반도체 시장도 지속적인 상승이 전망된다.

세계 반도체 무역 통계 기구(WSTS, World Semiconductor Trade Statistics)가 2021년 8월에 발표한 「반도체 시장 동향 자료」에 따르면, 2021년 세계 반도체 시장 규모는 5,508억 7,600만 달러(약 648조 6천억 원)로 추산된다.

특히, 2021년 세계 시스템 반도체 시장 규모는 약 2,985억 달러(약 352.4조 원)로 추산된다. 전체 반도체 시장에서 시스템 반도체의 점유율은 약 54%로 예상되며, 로직 IC(26.2%), 마이크로컴포넌트(10.9%), 아날로그 IC(29.1%) 모두 2020년 대비 두 자릿수 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 로직 IC에는 스마트폰용 AP나 디스플레이구동칩(DDI) 등이, 아날로그 IC에는 디지털-아날로그 신호 컨버터(DAC/ADC)나 전력관리반도체(PMIC) 등이 있다. 마이크로컴포넌트는 PC · 서버용 CPU, 차량 · 가전 · 산업용 마이크로컨트롤러(MCU)를 포함한다.

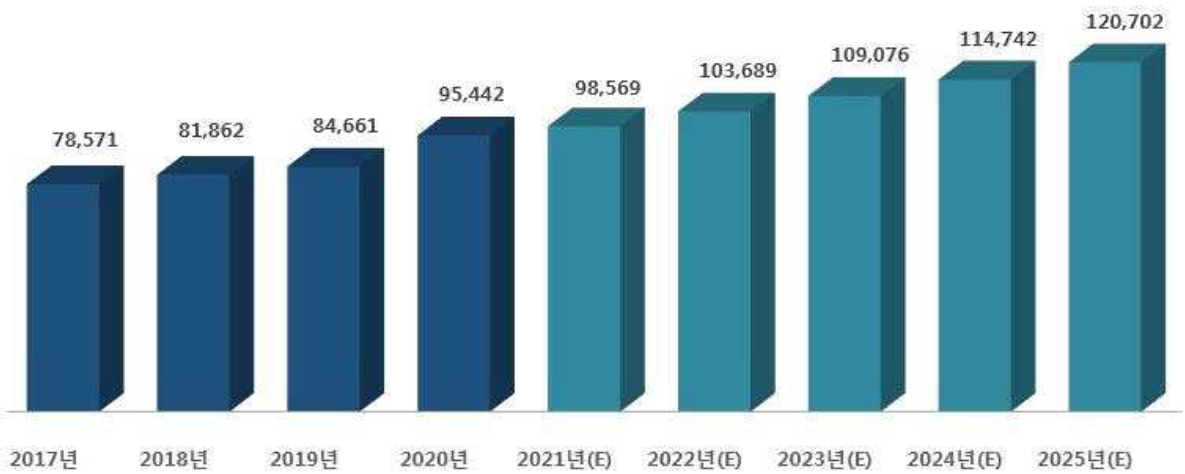
[표 4] 지역 및 유형별 세계 반도체 시장규모 및 전망 (단위 : 백만 달러, %)

분류	Amounts in US$M			Year on Year Growth in %		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Americas	95,366	115,868	129,773	21.3	21.5	12.0
Europe	37,520	47,440	51,138	-5.8	26.4	7.8
Japan	36,471	42,913	45,893	1.3	17.7	6.9
Asia Pacific	271,032	344,656	379,678	5.1	27.2	10.2
Total World - $M	**440,389**	**550,876**	**606,482**	**6.8**	**25.1**	**10.1**
Discrete Semiconductors	**23,804**	**29,389**	**30,936**	**-0.3**	**23.5**	**5.3**
Optoelectronics	40,397	43,137	44,967	-2.8	6.8	4.2
Sensors	14,962	18,666	19,790	10.7	24.8	6.0
Intergrated Circuits	361,226	459,685	510,788	8.4	27.3	11.1
Analog	55,658	71,882	76,757	3.2	29.1	6.8
Micro	69,678	77,305	80,922	4.9	10.9	4.7
Logic	118,408	149,388	162,341	11.1	26.2	8.7
Memory	117,482	161,110	190,769	10.4	37.1	18.4
Total Products - $M	**440,389**	**550,876**	**606,482**	**6.8**	**25.1**	**10.1**

***출처 : 세계 반도체 무역 통계 기구(WSTS), 반도체 시장 동향 자료(2021년 8월), 한국기업데이터(주) 재가공**

또한, 실리콘타임즈와 반도체산업협회에 따르면, 국내 시스템 반도체의 시장규모는 2017년 7조 8,571억 원에서 2020년 9조 5,442억 원을 기록하였으며, 향후 시장 환경, 업황 등을 고려할 때 2020년 이후 연평균 4.80% 증가하여, 2025년에는 12조 702억 원의 시장을 형성할 것으로 전망된다.

[그림 6] 국내 시스템 반도체 시장규모 및 전망 (단위 : 억 원)



***출처 : 실리콘타임즈, 반도체산업협회, 한국신용정보원, 한국기업데이터(주) 재가공**

■ 시스템 반도체 1위, 설계는 미국·생산은 대만

2021년 3월, 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 2020년 상위 10개 팹리스(반도체 설계기업) 중 1위는 미국의 퀄컴이며, 194억 700만 달러의 매출을 올려 2019년 대비 33.7% 증가했다. 2위는 브로드컴 177억 4,500만 달러로, 2019년 대비 2.9% 증가했다. 3위는 엔비디아 154억 1,200만 달러의 매출을 달성하여 2019년 대비 52.2% 매출 신장을 보였다. 4위 미디어텍과 5위 AMD는 각각 109억 2,900만 달러, 97억 6,300만 달러의 매출을 기록하여 2019년 대비 37.3%, 45% 성장했다.

[표 5] 2019~2020년 팹리스 상위 10개 업체 매출 비교 (단위 : 달러)

순위	기업명	국가	2019년 매출	2020년 매출	전년 대비 증감
1	퀄컴	미국	145억 1,800만	194억 700만	33.7%
2	브로드컴	미국	172억 4,600만	177억 4,500만	2.9%
3	엔비디아	미국	101억 2,500만	154억 1,200만	52.2%
4	미디어텍	대만	79억 6,200만	109억 2,900만	37.3%
5	AMD	미국	67억 3,100만	97억 6,300만	45.0%
6	자일링스	미국	32억 3,400만	30억 5,300만	-5.6%
7	마벨	미국	27억 800만	29억 4,200만	8.7%
8	노바텍	대만	20억 8,500만	27억 1,200만	30.1%
9	리얼텍	대만	19억 6,500만	26억 3,500만	34.1%
10	다이얼로그	영국	14억 2,100만	13억 7,600만	-3.2%

***출처 : 트렌스포스, 한국기업데이터(주) 재가공**

2019~2020년 팹리스 상위 10위 회사의 국적 분포를 살펴보면, 미국이 6곳, 대만 3곳, 영국 1곳으로, 국내 업체는 순위권에 들지 못했으며, KOTRA의 「한국 경제 성장을 견인하는 반도체 산업」 자료에 따르면, 국내 시스템 반도체 기업의 시장 점유율은 2020년 기준 2.9%에 불과하며, 더욱이 삼성전자를 제외한 나머지 기업들의 점유율은 1%도 되지 않는다. 또한, 점유율 17%의 대만과 15%의 중국과 비교해도 굉장히 낮은 수치이다.

[표 6] 국내 기업들의 글로벌 시장점유율 추이 (단위 : %)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
반도체 전체	15.5	16.2	17.0	16.5	21.4	23.6	18.4	18.4
메모리 반도체	48.7	53.0	57.7	57.4	60.7	61.7	58.4	56.9
시스템 반도체	5.5	3.9	3.6	3.1	3.0	3.0	3.2	2.9

***출처 : KOTRA, 한국 경제 성장을 견인하는 반도체 산업(2021년 9월), 한국기업데이터(주) 재가공**

시스템 반도체는 최근 데이터 경쟁이 치열해지며 AI, IoT 등으로 사용 분야가 확대되고 있어 성장 잠재력이 크다. 또한, 아직 시장 지배력이 월등한 회사가 없어 기술 전환이 빨리 이루어질 경우 국내 기업에도 기회가 열릴 수 있을 것으로 예상된다.

Ⅲ. 기술분석

우수한 Analog IP 확보를 통한 기술 진입 장벽 구축

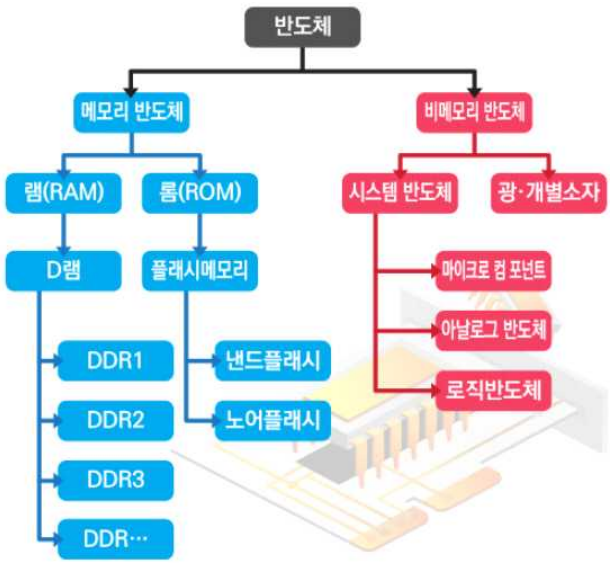
동사는 멀티미디어 기기 시장에서의 기술 변화를 예측하여 경쟁사 대비 우수한 Analog IP 보유를 통해 사전 핵심 기술을 확보하고 있으며, Set Maker와 파운드리 회사와의 파트너쉽 형성을 통한 진입장벽 형성하고 있어 원가경쟁력 및 시장의 수요를 지속적으로 확대하고 있다.

■ 반도체의 분류와 시스템 반도체의 특성

반도체는 데이터를 저장하는 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 분류하며, 비메모리 반도체는 시스템 반도체와 광·개별 소자로 분류할 수 있다. 메모리 반도체와 시스템 반도체는 다수의 소자를 하나의 칩안에 집적화한 집적회로(Integrated Circuit, IC)이며, 특히, 시스템 반도체는 정보의 처리, 제어, 가공 등을 담당하고, 광·개별 소자는 습득, 변환, 증폭 기능을 담당한다.

시스템 반도체는 국제적으로 통용되는 용어는 아니며, 세계 반도체 무역 통계 기구(WSTS)에서는 반도체를 메모리 반도체, 마이크로컴포넌트, 로직 IC, 아날로그 IC, 개별소자, 광전자(Optoelectronics) 및 센서로 분류한다.

[그림 7] 반도체의 분류



*출처 : 비즈니스와치

시스템 반도체는 범용성에 따라 범용 반도체와 주문형 반도체(Application Specific IC, ASIC)/특정용도 반도체(Application Specific Standard Product, ASSP)로 분류될 수 있다. 범용 반도체는 다양한 기기에 사용되는 반도체로 마이크로컨트롤러는 프로그래밍을 통해 다양한 연산, 제어가 가능하여 세탁기, 전기밥솥 등 다양한 전자제품에 탑재된다.

주문형 반도체(ASIC)는 특정 응용 분야, 기기의 특수 기능에 맞춰 설계된 반도체이며, 특정용도 반도체(ASSP)는 주문형 반도체를 표준화하여 다수 기업에 공급하는 형태로 퀄컴의 AP(Application Processor) 등이 있다.

■ 동사 주요 제품의 개요 및 특징

▶▶ AP(Application Processor) IC

AP IC란 스마트폰, 태블릿PC, 모바일 게임기, 디스플레이 기기 등에서 컴퓨터의 CPU와 같은 연산과 멀티미디어와 같은 핵심기능을 담당하는 시스템 반도체이다. 동사는 AP제품의 여러 가지 분야 중에서 자동차 인포테인먼트(Infortainment)용 SoC(System On a Chip) IC를 개발하였다. Audio 제품시장이 기존에 라디오, CD, USB 등의 매체를 이용하여 단순한 형태의 디스플레이를 사용하여 오디오 및 비디오를 재생하였다면, 동사가 개발한 TMMXX 제품은 컬러 LCD를 탑재하여 그래픽 사용자 인터페이스를 갖추고 있고, 비디오 재생, 후방카메라 등의 비디오 관련 기능을 갖추고 있으며, 스마트폰과도 연동되는 인포테인먼트 제품이다. 인포테인먼트는 정보(Information)와 엔터테인먼트(Entertainment)의 합성어로서 이전에 헤드유닛의 라디오나 CD 음악을 듣는 수준에서 모바일의 여러 기능을 받아들여 다양한 정보와 편의를 제공할 뿐만 아니라 더 나아가서 운전자의 안전을 돕는 다양한 기능을 장착하는 수준으로 발전을 하고 있다.

특히, 최근에는 대화면 컬러 LCD 디스플레이와 터치 입력장치를 장착하여 모바일 기기와 유사한 화려한 그래픽 사용자 인터페이스를 갖추고, 오디오/비디오 재생, 블루투스 통화, 후방 카메라 표시등의 기본 기능과 운전자의 스마트폰과 연동을 하며 인터넷 연결이나 앱 실행 등의 고급 기능을 갖는 디스플레이 오디오 시스템이 주요 세그먼트를 구성하고 있으며, 애플의 Car Play, 구글의 Android Auto 출시로 스마트폰 Connectivity가 디스플레이 오디오 시스템의 한 주축이 되고 있다.

[그림 8] 동사의 AP IC(좌)와 Optical IC(우)

*출처 : 동사 홈페이지

▶▶ Optical IC

동사의 Optical IC 제품인 S5L80XX 등은 이러한 일반 음악 CD는 물론, MP3, WMA(Windows Media Audio) 방식으로 압축 저장된 음악파일을 재생할 수 있는 CD MP3 Player에 들어가는 핵심 칩이다. MP3 파일을 CD Player에서 재생하였던 기존의 CD MP3 Player는 CD MP3 Player 용도이외의 불필요한 성능을 가진 범용 칩을 사용하거나 단일 기능을 하는 여러 가지 부가적인 칩들로 세트를 구성하여 MP3 파일을 재생함으로써 가격과 제품 개발 기간의 측면에서 비효율적이었다. 그러나 동사의 제품은 CD MP3 Player에 특화된 제품

으로서 CD MP3 Player 용도 이외의 불필요한 요소들을 제거함으로써 효율을 최적화하여 가격 경쟁력을 확보하였고, 세트업체가 제품을 개발하는데 편리한 각종 기능을 대폭 추가하여 동사 제품을 적용할 경우 최단 기간에 시장에 신제품을 출시할 수 있도록 하였다.

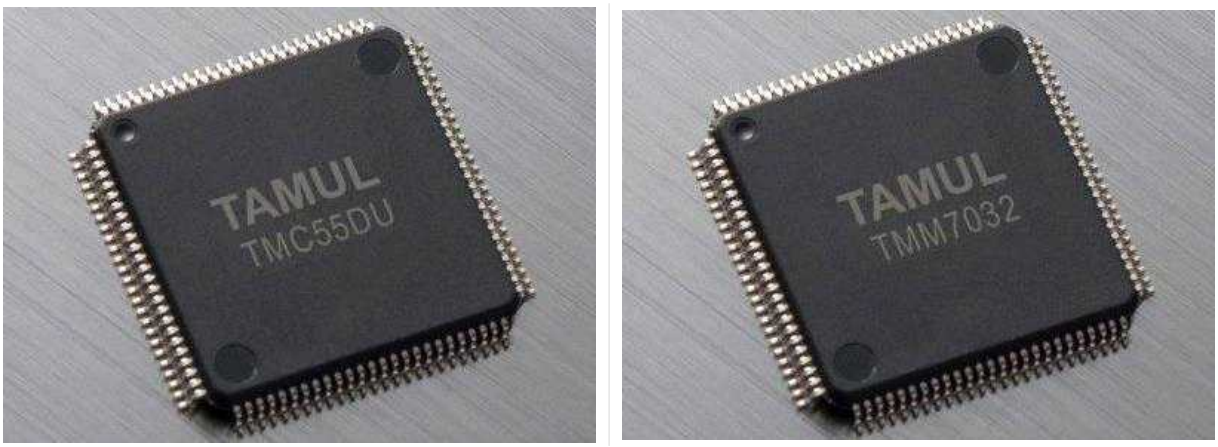
또한, 향후 출시될 다양한 압축포맷 형식을 수용할 수 있는 확장가능성이 높은 칩으로서, 새로운 압축포맷을 추가로 재생할 필요가 있을 경우 소비자 또는 세트업체가 손쉽게 프로그램을 다운받아 칩의 교환 없이도 기능을 업그레이드할 수 있게 하였으며, CD-ROM 데이터 포맷 표준과 MP3 압축파일 포맷 표준 및 WMA 압축파일 포맷표준을 만족하는 칩으로서, 기존의 다양한 CD-DSP 칩과의 완벽한 접속이 가능하며 호스트와의 효율적인 통신을 위해 다양한 통신 프로토콜을 제공하기도 한다.

▶▶ Multimedia Interface IC

동사의 Multimedia Interface IC는 USB 메모리/SD 카드/MMC(Multimedia Card)에 저장된 MP3 파일을 MP3 Player로 옮기지 않고 곧바로 재생가능하게 해주는 IC로 가정용과 자동차용 오디오에 USB/SD카드 포트를 설치하여 USB 메모리 또는 SD 카드 등에 저장된 음악 파일을 재생할 수 있게 하는 기능을 한다. 동사는 Multimedia Interface 기능이 처음으로 적용된 TMC5XX를 시작으로 6배속 실시간 MP3 Encoder가 내장된 TMC5XX와 Audio DAC(Digital to Analog Converter)까지 내장된 초저가형 원칩(one-chip) MP3/WMA Decoder인 TMC5XX를 개발해 현재 SET 업체를 대상으로 제품을 판매하고 있다.

Multimedia Interface IC는 다양한 멀티미디어 제품에 USB/SD 포트를 채택, 이동식 저장장치에 있는 MP3 파일을 손쉽게 재생 가능하기 때문에 어학용 기기 및 가정용 오디오 기기, CAR AUDIO, DMB, PMP, Navigation 등 오디오 기능을 요구하는 모든 멀티미디어 제품에 모두 적용 가능한 Interface IC이다.

[그림 9] 동사의 Multimedia Interface IC(좌)와 DAB IC(우)



***출처 : 동사 홈페이지**

▶▶ DAB(Digital Audio Broadcasting) IC

1995년부터 유럽에서 서비스되고 있는 DAB는 음성 수신만 가능했던 기존 아날로그방식 FM 라디오와 달리 음성과 함께 텍스트, 슬라이드 등의 데이터 서비스까지 제공할 수 있는 고품질의 디지털라디오 방송 규격으로서, 다양한 정보를 안정적으로 제공받고자 하는 방송 시장의 요구에

따라 2012년 독일·프랑스 등 여러 국가에서는 DAB로의 상용서비스 전환 및 신규 출시 차량의 DAB 탑재 의무화 법령 발표 등이 이루어지고 있으며 이를 계기로 그 수요가 급격히 증가할 것으로 전망된다.

동사의 DAB 수신 칩의 주요 특징으로는 T-DMB/DAB/ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting)-T/FM의 RF(Radio Frequency)와 Demodulator가 집적화된 Digital Radio의 Front-End SoC로서, 다양한 Back-End Processor와의 Interface를 통해 Digital Radio Solution을 구축할 수 있다. 또한, TMM70XX, TMC80XX 함께 기존의 Audio 시장을 공략할 수 있다는 장점이 있으며, 이러한 다른 사업군의 Chipset과의 Synergy는 Audio 시장에 새로운 Trend를 만들어 가고 있다.

■ Digital Convergence를 위한 필요 SoC 핵심 기술 확보

기존 멀티미디어 반도체 시장은 멀티미디어 제품의 Digital Convergence(복합기능화)로 인해 SoC 산업으로의 진화가 진행 중에 있다. 이에 따라 기존 여러 가지 시장으로 세분화 되어 있던 단일 기능의 반도체를 개발하여 공급하던 많은 반도체 업체들 간의 시장경계가 불투명해지면서 하나의 멀티미디어 SoC 시장을 두고 치열한 경쟁이 예상되고 있다.

동사는 멀티미디어 기기 시장에서의 기술 변화를 예측하여 경쟁사 대비 우수한 Analog IP 보유를 통해 사전 핵심 기술을 확보하고 있으며, 신속한 제품개발과 양질의 기술지원, 원가경쟁력 확보 등의 노력으로 세계시장 진입에 성공한 상황이다. 또한, 향후 치열한 경쟁 속에서 지속적 성장하기 위하여 기존의 단일 기능이 아닌 여러 기능을 하나의 칩으로 수행 가능한 SoC의 개발을 최종 목표로 하고 있다. 예를 들면, MPEG1에서 MPEG4를 기반으로 MP3 기능과 동영상 기능이 하나의 SoC로 수행 가능하게 하고, 더 나아가서는 DAB와 이동통신기능, 내비게이션 기능 등을 모두 하나의 칩으로 수행하게 함으로써 멀티미디어 기기의 소형화 및 저가격화를 가능하게 할 예정이다.

[그림 10] 동사의 경쟁 우위 (1) - SoC 핵심 기술

*출처 : 동사

■ Set Maker와 파운드리 회사와의 파트너쉽 형성을 통한 진입장벽 형성

동사는 시장의 요구 사항을 최대한 반영하면서도 개발기간을 단축하기 위해 전사적인 노력을 기울이고 있다. 대부분의 멀티미디어 기기 제조업체(SET Maker)는 제품의 기획에서 실제 대량 생산까지의 소요 기간이 6개월 이상이 소요되므로 이미 제품의 기획 초기에 가장 중요한 핵심 부품인 멀티미디어 반도체에 대한 채택 여부 및 적합성 검사가 완료 되어야 한다. 따라서 동사와 같은 SoC 업체는 최소 향후 1년 이후 시장 변화를 사전 감지하여 제품 개발하고, 개발된 반도체가 최종 제품에 채택될 수 있도록 사전에 SET Maker와의 긴밀한 정보 교환 및 기술지원이 필수적이다. 이를 위해 동사는 시장 불확실성을 최소화하기 위해 다양한 업체 지원을 통하여 고객의 요구를 신속히 반영할 수 있는 개발 체제를 구축하고 있고, 이를 최대한 활용하여 신제품 개발 시 최종 SET Maker가 개발기간을 단축시킬 수 있도록 제품 개발 전 과정에서 최종 SET Maker와의 정보공유 및 기술지원을 통해 개발 기간을 최소화할 수 있도록 하고 있다.

또한, SoC 제품 판매를 확대할 목적으로 동사의 SoC 제품을 가지고 타겟 시스템에 맞춤형으로 솔루션을 개발하고 있으며, 외부의 솔루션 파트너들과 긴밀한 파트너쉽을 형성하여 원가경쟁력 및 시장의 수요를 확대하고 있다.

[그림 11] 동사의 경쟁 우위 (2) - 파트너쉽을 통한 진입장벽

*출처 : 동사

■ 효율적인 설계를 통한 가격 경쟁력 확보

반도체에서 성능의 우수성과 함께 가장 중요한 요소는 SET제조업체들이 요구하는 기능의 IC를 가장 저렴한 가격으로 공급할 수 있느냐 인데, 아무리 성능이 뛰어나고 다양한 기능을 SoC화 하는데 성공하였다할지라도 실제로 SET 공급업체가 요구하는 기능보다 지나치게 고사양일 경우 원가 경쟁력을 상실해 시장성이 떨어지게 된다.

그러나 동사는 제품 기획 단계에서부터 철저하게 원가경쟁력을 고려한 효율적 설계를 진행하고 있으며, 양산과정에서 일어 날수 있는 원가상승 요인을 사전에 제거하기 위해 파운드리 회사와 기술협력을 통해 개발 단계에서부터 원가절감을 최대화하고 있다. 향후 SoC 개발에서도 원가상승 없이 동일한 가격에 여러 기능을 추가하여 상대적 원가절감 효과를 누릴 수 있도록 할 계획이며, 지속적으로 경비절감 노력을 기울여 원가절감 효과를 배가시킬 계획을 보유하고 있다.

■ 기업부설연구소 중심의 R&D 역량 강화

동사는 한국산업기술진흥협회에서 공인된 다믈멀티미디어(주) 부설연구소(최초인정일 : 2001년 7월)를 설립·운영하고 있으며, 최근 스마트폰과 헤드유닛의 연동을 통해 통화는 물론 음악, 인터넷 라디오, 각종 앱, 내비게이션 등 사용자의 스마트폰에 있는 기능을 디스플레이에서도 동일하게 사용할 수 있게 제공하는 반도체 및 솔루션을 개발하고 있다.

또한, 동사 제품은 기능적 측면에서 1920x1080 LCD Resolution, 1080p (FHD급) Video Decoder, Wireless Carplay and Android Auto, 3D Graphic Accelerator, DDR SDRAM, LVDS LCD Input, Quick Booting Rear Cam 등의 기능을 구현하였으며, 국내외 경쟁사에 비해 최고의 원가경쟁력 확보를 위해 연구개발하고 있다.

최근 3년간 평균 연구개발투자비율은 11.2%로 산업 평균 3.7% 대비 높은 수준이며, 핵심기술과 관련된 특허권 3건을 보유하고 있어 핵심기술의 보호와 관련된 사업 보완적 수단을 갖추고 있는 것으로 판단된다.

[표 7] 연구개발투자비용 (단위 : 백만 원)

과목	2018년	2019년	2020년	2021년 3분기
연구개발비용 계	2,006	955	733	519
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 ÷ 당기매출액 × 100]	18.0%	7.3%	8.3%	6.5%

*출처 : 동사 연도별 사업보고서, 분기보고서(2021년 9월), 한국기업데이터(주) 재가공

[표 8] 제품 개발 현황

연구과제명	연구결과 및 기대효과	상품화
고성능/ 다기능을 가진 멀티미디어 SoC IC	▪ RF AMP, D-Servo, CD DSP, CD-ROM Decoder, Audio/System Processor, PWM Processor, SD/MMC, USB Host/Slave 등 Audio 멀티미디어 Platform을 가진 Optical MP3 SoC IC를 출시하여 Optical MP3 분야에서 M/S를 확대해 나갈 수 있는 토대를 마련함과 동시에 차기 기술과제에 대한 기반 기술 개발.	S5L80XX
HD급 Video를 지원하는 Application Processor IC	▪ Application Processor로서 MPEG1/2/4, Divx, WMV, H.264, RV 등 HD급 Video 지원, 다양한 Audio 포맷 지원하고 Audio/Video In/Out 및 여러 Peripheral I/F와 Storage I/F를 지원하는 등 다양한 용도의 Application 적용 ▪ Rear View Camera를 지원할 수 있고 당사 CD Platform과 연계하여 차량용 CD AV System과 Mechless CAR AV 에도 적용하여 시장 확판 기대.	TMM92XX
FHD급 Video를 지원하는 Application Processor IC	▪ Application Processor로서 MPEG1/2/4, Divx, WMV, H.264, RV 등 FHD급 Video 지원, 다양한 Audio 포맷 지원하고 Audio/Video In/Out 및 여러 Peripheral I/F와 Storage I/F를 지원하는 등 다양한 용도의 Application 적용 ▪ Display Audio 시장이 점차 증가함에 따라 Linux 기반 Wireless Carplay and Android Auto, FHD Resolution LCD, DDR3 Memory 적용하여 CAR AV 시장 제품 라인업 확대 및 신제품 개발 대응.	TMM93XX

*출처 : 동사 분기보고서(2021년 9월), 한국기업데이터(주) 재가공

IV. 재무분석

제품 다각화, 해외시장 확대 등으로 안정적인 매출 시현

동사는 최근 글로벌 경기 회복세 및 자동차 등 전방산업의 성장으로 2021년 3분기 양호한 매출 성장과 흑자전환을 하였으며, 전기자동차 및 자율주행차 시장의 확대에 따른 관련 설계의 수요 증가세 등으로 제품 다각화하고 있어, 향후 외형 성장이 지속될 것으로 전망된다.

■ 신규 사업을 통해 성장 기대

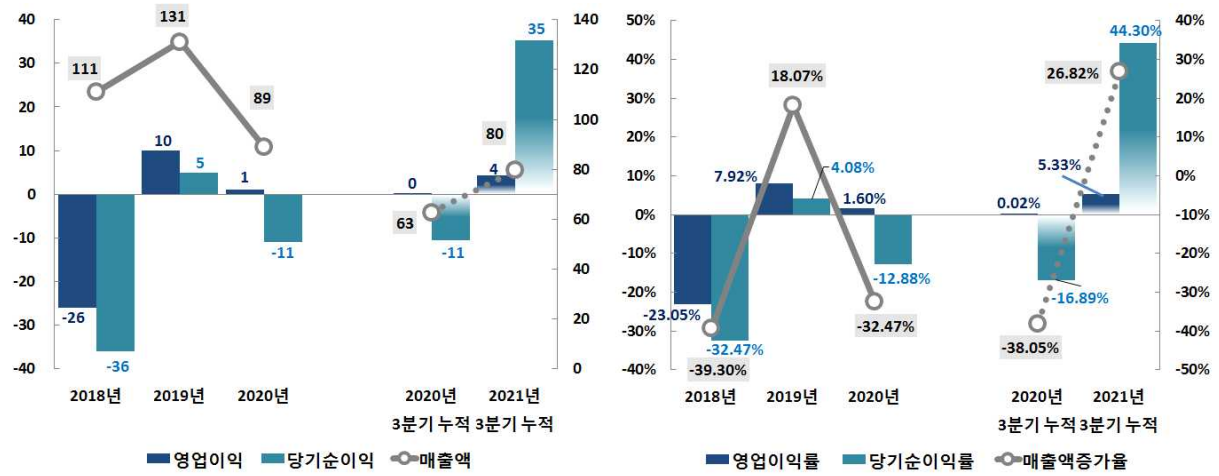
동사는 멀티미디어와 통신용 비메모리 반도체칩의 설계 및 개발을 주력사업으로 영위하고 있으며, 반도체 펩리스 업체로 멀티미디어 SoC 설계기술을 바탕으로 AP IC, Multimedia Interface IC 등을 개발 및 판매하고 있다.

동사는 2018년 매출액 111억 원, 2019년 131억 원을 기록한 이후 코로나19 영향으로 자동차 산업군 등의 전방산업의 수요가 감소하여 2020년 매출액은 89억 원으로 전년 대비 32.47% 감소하였다. 영업이익(순이익)은 2018년 -26억 원(-36억 원), 2019년 10억 원(5억 원), 2020년 1억 원(-11억 원)으로 코로나 사태 장기화에 따른 매출감소로 수익성 지표가 저하되는 경향을 보이고 있다.

한편, 글로벌 경기 회복세 및 자동차 등 전방산업의 성장으로 과년 AP IC와 DAB IC의 수주가 증가하여 2021년 3분기 누적 매출액은 80억 원으로 전년 동기 대비 26.82% 증가하였고, 양호한 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익(순이익)은 4억 원(35억 원)으로 전년 동기 대비 4억 원(46억 원) 증가하였다.

동사는 사업부문 다양화 전략에 따라 해외비중을 높이고 있으며, 전기자동차 및 자율주행차 시장의 확대에 따른 관련 설계의 수요 증가세 등으로, 차량용 반도체와 관련된 제품을 중점으로 개발하고 있어, 향후 외형 성장세 지속과 수익성 개선을 기대할 수 있을 것으로 보인다.

[그림 12] 요약 포괄손익계산서 분석 [K-IFRS 별도기준] (단위 : 억 원)

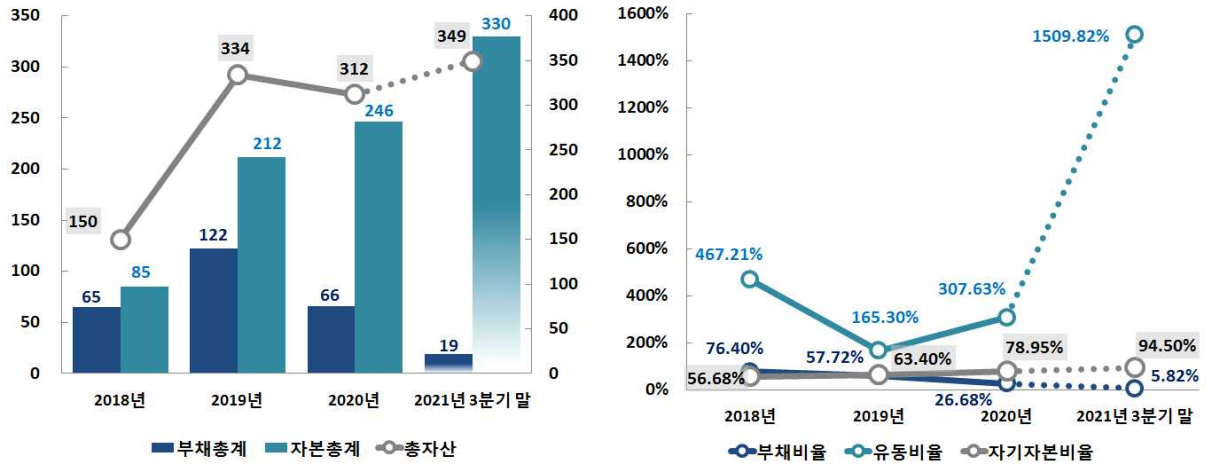


*출처 : 동사 연도별 사업보고서, 분기보고서(2021년 9월), 한국기업데이터(주) 재가공

■ 풍부한 내부유보자금 등 안정적인 재무구조 견지

동사의 총자산은 2019년 말 334억 원에서 2020년 말 312억 원으로 6.52% 감소하였고 2021년 3분기 말 349억 원으로 증가하였다. 부채비율은 2018년 말 76.4%, 2019년 말 57.72%, 2020년 말 26.68%이고 유동비율은 2018년 말 467.21%, 2019년 말 165.3%, 2020년 말 307.63%이다. 2021년 3분기 말 부채비율은 5.82%, 유동비율은 1509.82%로 부채비율, 유동비율이 2020년 말 대비 개선되었으며, 동사의 재무구조는 안정적인 것으로 판단된다.

[그림 13] 요약 재무상태표 분석 [K-IFRS 별도기준] (단위 : 억 원)

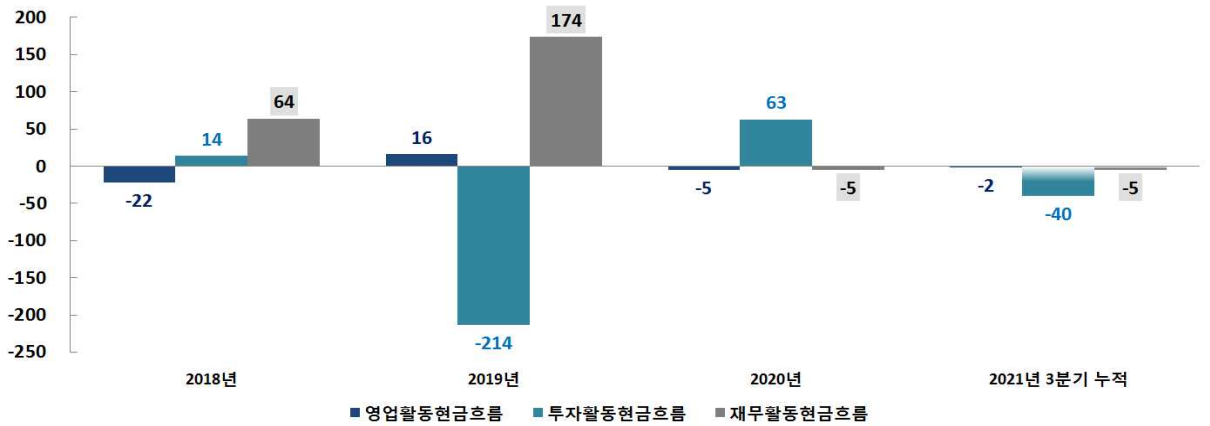


*출처 : 동사 연도별 사업보고서, 분기보고서(2021년 9월), 한국기업데이터(주) 재가공

동사의 영업활동현금흐름은 당기순손실 발생, 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 등으로 2019년 정(+)에서 2020년 부(−)의 흐름을 나타내었고, 투자활동현금흐름은 단기금융상품의 감소 등으로 2019년 부(−)에서 2020년 정(+)의 흐름을 나타내었으며, 재무활동현금흐름은 유동성장기부채의 상환 등으로 2019년 정(+)에서 2020년 부(−)의 흐름을 나타내었다.

2021년 3분기 누적 현금흐름을 볼 때, 동사는 영업활동, 투자활동, 재무활동 모두 현금 유출이 유입을 초과하고 있어 기말현금및현금성자산이 기초 대비 감소하였고, 기말현금및현금성자산으로 기초 대비 46억 원 감소한 51억 원을 보유하고 있다.

[그림 14] 현금흐름 분석 [K-IFRS 별도기준] (단위 : 억 원)



*출처 : 동사 연도별 사업보고서, 분기보고서(2021년 9월), 한국기업데이터(주) 재가공

V. 주요 변동사항 및 향후 전망

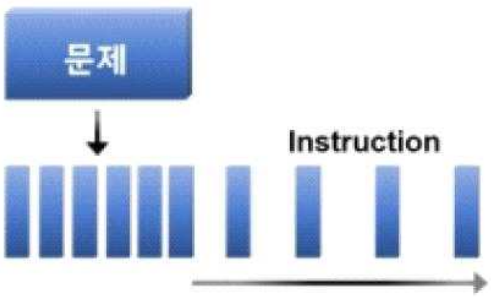
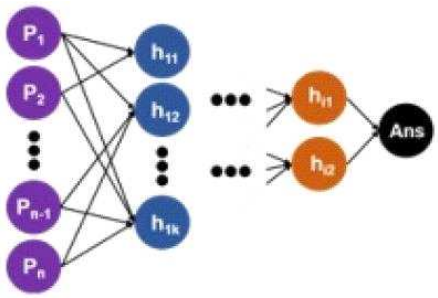
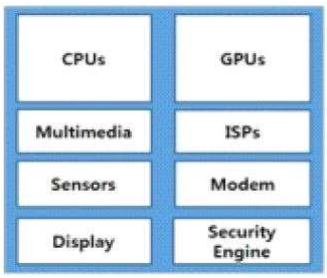
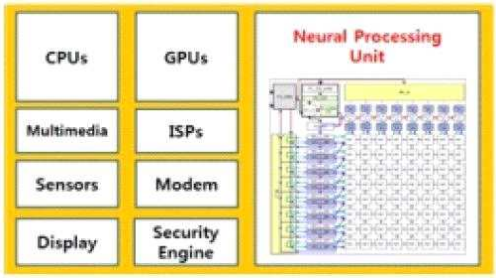
지배구조 개선을 통한 안정성 확대

동사는 최근 약화된 지배구조를 강화하기 위해 최대주주 및 대표이사가 변경되었으며, 시스템 반도체 산업의 변화에 발맞추어 자체적으로 보유한 기술을 근간으로 한 제품 개발뿐만 아니라, 타 기술 업체와 기술 교류를 통한 경쟁력 있는 제품 개발에 정진하고 있다.

■ 4차 산업혁명의 영향으로 차세대 인공지능 반도체로 진화 중

최근 4차 산업혁명으로 인하여 반도체 산업은 인공지능, IoT, 클라우드, 빅데이터, 가상현실, 자율주행 등을 구현할 수 있는 새로운 패러다임의 반도체 기술이 필요하게 되었다. 특히, 로봇, 자동차, PC, 서버, 스마트폰, 가전 등 모든 사물(제품)에는 인공지능 서비스를 구현할 수 있는 '다기능 융복합 반도체' 의 필요성이 대두되었으며, 이러한 변화에 맞춰 인식 · 추론 · 학습 · 판단 등 인공지능 서비스에 최적화(지능화, 저전력화, 안정화)된 소프트웨어와 시스템 반도체가 융합된 반도체인 차세대 인공지능형 반도체(지능형 반도체)가 등장하게 되었다. 이러한 지능형 반도체는 개인형 인공지능 디바이스, 자율이동체, 지능형 헬스케어, 빅데이터 처리, 차세대 통신 서비스, 스마트시티, 증강현실, 인간형 지능로봇, 신약 개발, 에너지 등 사회, 경제, 국방 전 분야에 응용될 것으로 전망되고 있다.

[표 9] 기존 반도체와 차세대 지능형 반도체의 차이점

구분	기존 반도체	차세대 인공지능 반도체
기술 특징	데이터를 프로그램대로 순차적 처리	인간의 뇌처럼 기억, 연산을 대량으로 동시(병렬) 처리
구조	 [순환 선형 신호처리]	 [대규모 병렬 비선형 신호처리]
반도체 블록도 (예시)	 [모바일용 기존 반도체]	 [모바일용 지능형 반도체]

*출처 : 과학기술정보통신부, 한국기업데이터(주) 재가공

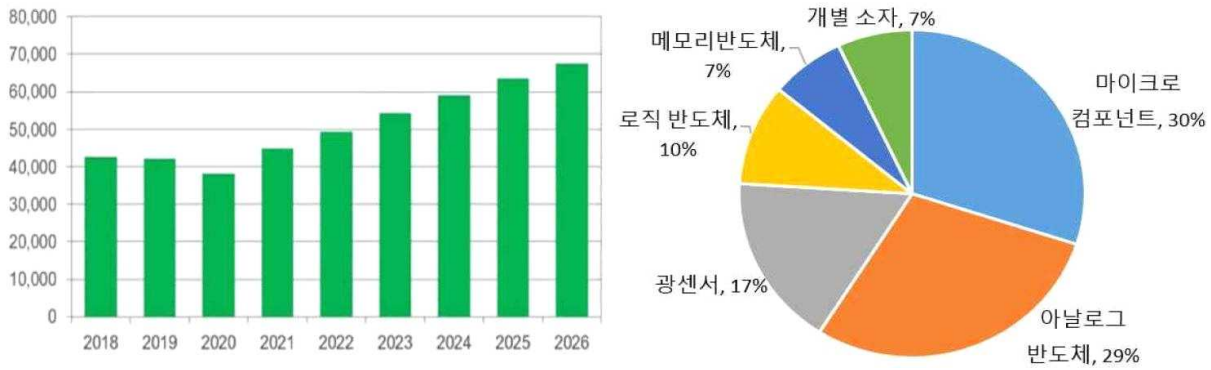
세계 반도체 시장은 정보통신 시대를 넘어서 인공지능 컴퓨팅을 위한 지능형 반도체 시대로 급격한 패러다임 전환 시기를 맞고 있으며, 이를 위하여 국가별, 글로벌 기업별로 차세대 반도체인 지능형 반도체의 자체 연구개발을 본격적으로 시작하고 있다. 인공지능 서비스 성장에 따른 지능형 ICT 융합 제품 수요도 증가하여 반도체 시장은 지능형 반도체 중심으로 재편될 것으로 전망되며, 지능형 반도체의 적용 및 활용 분야가 광범위해지고, 고성능 · 저전력 · 초경량 등의 지속적인 진보와 더불어 생산비용 절감은 기존 반도체에 대한 대체 가능성을 높이고 있다.

■ 차량용 반도체 부족, 2022년에도 수급 불균형 지속될 예정

최근 자동차 판매 증가 및 파운드리 기업의 생산능력 제약(코로나19 확산으로 공장 가동이 대거 중단) 등으로 차량용 반도체 부족 사태가 발생했다. 그러나 2021년 중순 이후 백신 보급으로 공장 가동률이 높아지고, 글로벌 완성차업체들도 대체 소재를 발굴하거나 아예 일부 반도체를 빼고 차량을 출고하는 방식으로 대응하면서 추가 악화는 막았으며, 국내 완성차 업체도 2021년 차량용 반도체가 필요한 일부 편의사양(옵션)을 제외하는 대신 출고가를 낮춰 판매하는 '마이너스 옵션'을 인기 모델에 대거 적용했다.

글로벌 반도체 업체 입장에서는 차량용 반도체의 수익성이 여전히 낮아 생산능력 확충에 적극적이지 않은 반면, 첨단 전자장비가 적용되는 전장화와 전기차 전환 가속으로 차량용 반도체 시장규모는 2020년 380억 달러에서 2026년 676억 달러로 연평균 10% 성장이 전망되고 있다.

[그림 15] 차량용 반도체 시장규모(좌) 및 반도체 기능별 비중(우) (단위 : 백만 달러, %)



***출처 : 한국수출입은행 해외경제연구소, 차량용 반도체 공급부족의 원인 및 영향(2021년 3월)**

이에 미국 포드社는 2021년 11월 미국 반도체 위탁 생산업체인 글로벌 파운드리와 반도체 개발 전략적 제휴를 맺었고, GM社도 네덜란드 NXP 반도체와 제휴를 맺어 공동 개발 및 생산에 합의하는 등 글로벌 완성차 업체들은 자체적인 반도체 공급망 확보에 사활을 걸고 있다.

세계적인 차량용 반도체 부족 사태가 완성차 업계의 자구 노력에 힘입어 추가 악화 흐름에서는 벗어났으나, 반도체 회사들이 수익성 적은 차량용 반도체의 생산 확충에 여전히 소극적인 반면, 전기차 전환 가속화로 수요는 급증하는 추세이며, 차량용 반도체 물량이 나오기까지는 상당한 시간이 소요되어 2022년에도 차량용 반도체의 수급 불균형은 지속될 것으로 전망된다.

국내 자동차 산업도 반도체 공급 부족 장기화 시 생산차질이 불가피하며, 우리나라 팹리스 기업은 완성차 기업의 부품 공급사 다변화 추진으로 차량용 반도체 사업 기회가 확대될 가능성이 있어, 차량용 반도체 개발을 하고 있는 동사 역시 수혜가 기대된다.

■ K-반도체 파격 지원, '반도체 특별법' 2022년 하반기 시행

2022년 1월, 반도체를 포함한 국가첨단전략사업을 지원하는 내용의 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 육성에 관한 특별조치법(반도체특별법)」 제정 공포안이 국무회의에서 의결되었다.

산업통상자원부에 따르면, 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 육성에 관한 특별조치법(반도체특별법)」은 글로벌 첨단산업 주도권 경쟁에서 우위를 점하기 위해 '국가첨단전략기술'을 지정하고, 관련 산업인 '국가첨단전략산업'을 강력히 육성·보호하기 위한 방안을 담고 있다. 이 특별법은 공포 후 6개월 뒤인 2022년 하반기부터 시행될 예정이며, 특별법에 따라 국무총리 소속으로 '국가첨단전략산업위원회'가 구성되어 국가첨단전략기술 및 산업에 대한 주요 지원정책을 심의·의결한다. 산업부장관은 5년 단위로 전략 산업 등의 육성·보호 기본계획을 세우고 관계 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 매년 실행계획을 수립·시행한다.

[그림 16] 국가첨단전략산업 특별법 기업 지원 내용 요약(좌) 및 국가별 반도체 산업 육성정책(우)

***출처 : News 1, 아시아경제**

또한, 산업부장관은 지정요건에 부합하는 산업기술을 기술조정위원회 심의 및 국가첨단전략산업위원회 심의·의결을 거쳐 전략기술로 지정하며, 산업부는 후속 조치로서 국가첨단전략산업위원회 구성안을 관계부처와 논의하고 법이 시행되면 기본계획 수립에 착수할 예정이다.

산업부는 전략산업 지원 내용과 절차를 하위법령을 통해 구체화하고, 3~4월 중 입법 예고해 업계 의견을 수렴·반영할 방침이며, 전략산업을 영위하는 기업이 연구개발 및 생산 활동 등과 관련된 규제 개선을 신청하면 관계 행정기관의 장이 15일 이내에 결과를 회신해야 한다.

정부는 기업 간 연대협력 활성화를 위해 국가첨단전략산업 연대협력 모델을 발굴, 행정적·기술적·재정적 지원을 제공한다. 전략기술로 지정되면 산업기술보호법상 국가핵심기술로 지정된 것으로 간주하며, 기술 수출·인수합병이 있는 경우 산업부장관의 사전승인을 받아야 한다.

세계 주요국들이 자국의 첨단산업 경쟁력 강화에 나선 상황에서 국내 산업 주도권을 확보하려면 국가첨단전략산업의 육성보호가 중요하며, 올해 하반기 법 시행과 함께 반도체·이차전지 등 주요 첨단산업의 역량 강화를 신속하게 지원하기 위해 산업부는 전략기술 지정, 지원내용, 보호조치 등을 설명하는 업계 간담회를 상반기 중 열 계획이다.

■ (주)베노홀딩스로 인수 및 대표이사 변경

2021년 8월, 동사는 기존 최대주주였던 (주)우리로가 보유주식 합계 보통주 168만 5,693주를 150억 원에 (주)베노홀딩스에 양도하는 주식양수도 계약을 체결했다고 공시했다. 이 계약으로 2021년 10월 잔금 지급 및 주권 이전이 완료됨에 따라, 최대주주가 (주)베노홀딩스로 변경되었으며, 이에 따라 (주)베노홀딩스의 대표이사인 정집훈이 동사의 대표이사직을 맡게 되었다.

[표 10] 인수 전후 변동 사항

구분	변경 전	변경 후
최대주주	(주)우리로	(주)베노홀딩스
소유 주식 수(주)	1,685,693	2,419,308
소유비율(%)	11.70	16.80
대표이사	박세철	정집훈

***출처 : 전자공시시스템, 한국기업데이터(주) 재가공**

■ 동사의 ESG 활동

ENVIRONMENTAL

동사는 환경(E) 부문에서 환경(대기, 수질, 폐기물, 화학물질 등) 관련 법규 준수를 위한 'ISO 14001(환경경영시스템)' 기반 환경경영체제를 구축하여 운영하고 있으며, 유해화학물질 관리를 통해 사용이 제한되는 법정 규제물질과 자발적 제한물질을 엄격하게 관리·검사하고 제품의 제조, 유통, 사용 및 폐기의 전 과정에 걸쳐 환경영향을 최소화하기 위해 노력하고 있다.

SOCIAL

사회(S) 부문에서는 기본적으로 ISO 9001(품질경영시스템) 기반 산업안전 및 품질안전을 위한 시스템을 갖추고 있으며, 벤처기업, 이노비즈(INNO-BIZ) 인증을 보유하고 있다. 또한, 차별금지, 인권존중을 중시하는 경영원칙에 따라 수년간 기간제 근로자 채용 없이 정규직으로만 채용하고 있으며, 이러한 가운데 구성원들을 위해 쾌적하고 효율적인 업무 환경을 제공함과 동시에 워라밸을 고려하여 경조사 지원(경조금, 화환, 경조휴가 등), 건강검진 지원, 자기개발 지원(외국어교육비, 도서 등), 기념일 선물 지급(설, 추석, 창립기념일 등), 부서운영비 지원 등을 운영하고 있다.

[표 11] 보유 인증 현황

인증명	인정기관명	인증일자
ISO 9001	KAB	2020.03.30
ISO 14001	KAB	2020.03.30
벤처기업	기술보증기금	2020.05.14
이노비즈(INNO-BIZ)	중소벤처기업부	2020.12.18

***출처 : 동사 홈페이지, 한국기업데이터(주) 재가공**

GOVERNANCE

지배구조(G)의 경우, 동사의 이사회는 분기보고서(2021년 9월) 기준 등기 대표이사 1인을 포함한 사내이사 3명, 비상근 감사 1명으로 구성되어 있다. 동사는 상법 및 정관, 이사회 규정에서 규정한 회사 경영에 관한 중요 사항들에 대해서는 이사회에서 직접 의결하고 있으나, 일반적인 경영결정 사항들에 대해서는 신속하고 원활한 경영 의사결정 등을 위하여 상근이사 및 대표이사가 하고 있다.

또한, 동사는 기업가치의 극대화를 목표로 하여 향후 투자계획 및 재무환경 등을 종합적으로 고려하여 상법상 배당가능이익 내에서 배당규모를 결정하고 있다.

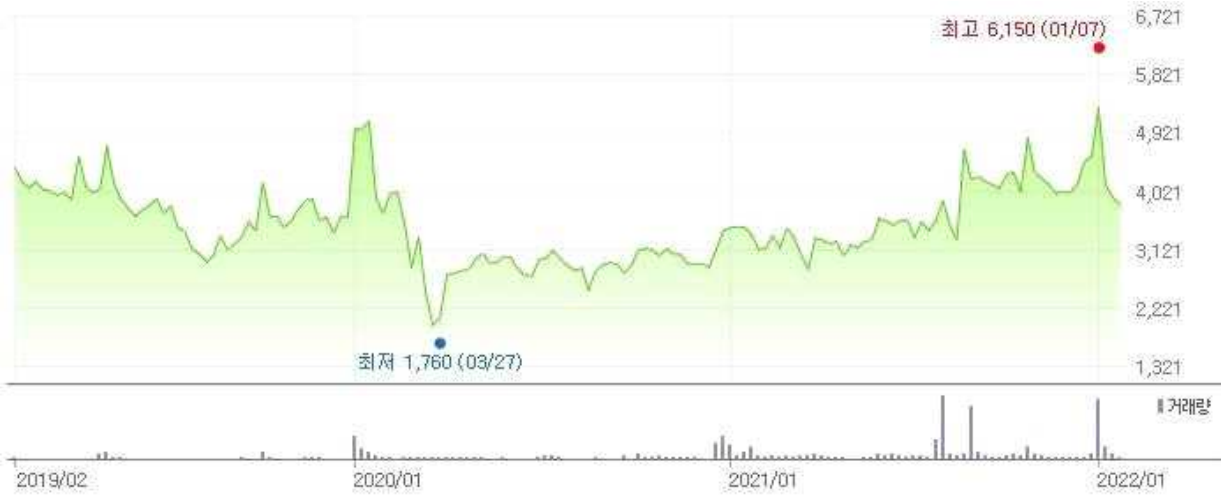
정보공개와 주주 권익 보호 측면에서 ESG 관련 정보공개는 부족한 수준이나, 상장회사로서의 공시 의무를 준수하며, 소통 채널 다양성 확보, 정보 접근 등의 권한을 준수하기 홈페이지에 최신 소개 자료를 업데이트 하는 등 이해관계자의 권익 보호를 위한 노력은 일정 수준 이상으로 전개하고 있다.

■ 증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
	· 최근 1년 이내 발간 보고서 없음		

■ 시장정보(주가 및 거래량)

[그림 17] 동사 3개년 주가 변동 현황



*출처 : 네이버 금융(2022년 1월 27일)